

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于上海艾为电子技术股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）作为上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“艾为电子”、“公司”）持续督导的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对艾为电子部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金总额	320,104.40万元
募集资金净额	303,526.14万元
募集资金到账时间	2021年8月10日

根据中国证券监督管理委员会于2021年6月4日出具的《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1953号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股4,180万股，每股发行价格为76.58元，募集资金总额为人民币3,201,044,000元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币3,035,261,414.64元。上述募集资金已于2021年8月10日全部到账并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2021】第4-00042号《验资报告》。

### 二、募投项目基本情况

根据《上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发

行费用后将用于如下项目：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	使用募集资金投入金额 (万元)
1	智能音频芯片研发和产业化项目	44,164.59	44,164.59
2	5G 射频器件研发和产业化项目	21,177.05	21,177.05
3	马达驱动芯片研发和产业化项目	36,789.12	36,789.12
4	研发中心建设项目	40,824.76	40,824.76
5	电子工程测试中心建设项目	73,858.20	73,858.20
6	发展与科技储备资金	30,000.00	30,000.00
合计		<b>246,813.72</b>	<b>246,813.72</b>

公司分别于2023年4月13日、2023年5月11日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议及2022年年度股东大会，审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用剩余全部超募资金47,220万元及其衍生利息、现金管理收益用于投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述新项目计划投资总额为47,747.45万元，拟使用剩余超募资金47,220万元及其衍生利息、现金管理收益，剩余资金以自有资金补足。项目具体情况如下：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	使用募集资金投入金额 (万元)
1	高性能模拟芯片研发和产业化项目	47,747.45	47,220.00
合计		<b>47,747.45</b>	<b>47,220.00</b>

公司分别于2023年10月26日、2023年11月14日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议及2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》，同意对“研发中心建设项目”结项后，公司拟将剩余募集资金18,932.47万元及其衍生利息、现金管理收益1,251.13万元，合计约20,183.60万元（具体金额以划拨日为准）用于公司募投项目“电子工程测试中心建设项目”，并调整募集资金投资项目“电子工程测试中心建设项目”的内部投资结构。调整后“电子工程测试中心建设项目”投资总额由73,858.20万元变更为94,041.80万元（具体金额以划拨日为准），募集资金承诺投资总额由73,858.20万元变更为94,041.80万元（具体金额以划拨日为准）。公司于2023年12月5日进行了划拨，实际划拨金额为20,205.00万元，实际

投资总额变更为94,063.20万元。

2024年4月8日，本公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目延期和部分募投项目内部投资结构调整及增加募投项目实施主体的议案》，因外部环境变化，公司无法与临港规资处有效沟通导致拿地方案的审批推迟，亦无法与政府部门各委办单位有效沟通导致并联征询批复意见延缓。在取得产证后根据主管部门对用地地块的设计要求，设计单位重新对施工图进行调整修改，建设规模超过原先体量，项目新增设计两层地下室，整体施工周期增加，并需要主管部门对设计方案及施工组织方案重新进行专家评审，导致项目建设周期拉长，本项目投产时间也将随之顺延，董事会同意对“电子工程测试中心建设项目”将原计划达到预定可使用状态日期2024年8月延期至2026年3月。

2025年7月27日，本公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目调整及延期的议案》，由于宏观市场环境、行业技术发展、公司经营战略等因素变化，公司对研发项目规划进行了调整，拟将原用于“发展与科技储备资金”中的子项目拟投资金额进行调整，公司拟加大对55nm和40nm BCD先进工艺导入的投入，根据对未来投入规划的测算，将募投项目延期至2026年8月，以实现募投项目建设基础平台性及前瞻性的技术的目标。保荐人就此事出具了明确的核查意见。

2025年8月12日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的议案》，“高性能模拟芯片研发和产业化项目”原计划达到预定可使用状态日期为2026年6月，该项目包括高性能电源管理芯片产品开发和信号链芯片产品开发，项目产品具有种类多、范围广、部分品类开发专业性门槛高等特点，随着细分市场竞争加剧，公司需要更多的时间分析最新市场需求，根据需求进一步升级迭代产品，以更好的适应市场变化，优化资源配置。同时，“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”和“马达驱动芯片研发和产业化项目”的节余募集资金20,075.57万元投入“高性能模拟芯片研发和产业化项目”后，可以支撑公司高性能模拟芯片的后续研发投入

和升级迭代。在综合考量当前市场需求、募投项目进度、更有效利用募集资金和公司长期发展规划后，将“高性能模拟芯片研发和产业化项目”达到预定可使用状态日期相应延期至2027年12月。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

### 三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

#### （一）募投项目结项的具体情况

结项名称	电子工程测试中心建设项目
结项时间	2026年3月31日
募集资金承诺使用金额	94,063.20万元
募集资金实际使用金额	78,293.90万元
利息及理财收益（扣除手续费）	3,356.49万元
预计尚需支付的募集资金金额	11,548.05万元
节余募集资金金额	7,577.74万元
节余募集资金使用用途及相应金额	<input checked="" type="checkbox"/> 补流，7,577.74万元

注：1、实际“节余募集资金金额”以资金转出当日专户余额为准；

2、“预计尚需支付的募集资金金额”包含尚未支付的合同尾款延期，不足部分以自有资金支付，最终金额以项目实际支付为准；

3、所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

#### （二）募集资金节余的主要原因

在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着节约、审慎使用、费用管控的原则，在保证募投项目质量和风险控制的前提下，加强了对募投项目中各环节费用的控制、监督和管理，有效降低了募投项目实施成本；此外公司通过闲置募集资金现金管理购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，增加了募集资金利息和理财收益，使得本次募投项目募集资金节余。

### 四、节余募集资金使用计划

截至2026年3月31日，“电子工程测试中心建设项目”的募集资金余额合计为19,125.79万元，公司拟将募集资金余额扣除已签订合同待支付款项11,548.05万元后的7,577.74万元永久补充流动资金，最终转入公司自有资金账户的实际金额以募集资金专户注销日转出该项目募集资金账户的全部余额为准。

在相关募集资金专户注销前，“电子工程测试中心建设项目”已签订合同待

支付款项仍由相关募集资金专户支付；待节余募集资金投入“电子工程测试中心建设项目”事项完成且募集资金专户注销后，剩余待支付款项将以自有资金支付。节余募集资金全部转出完毕后，公司将办理相关募集资金专户销户手续，公司与保荐人、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

## 五、审议程序

2026年4月8日，第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审核通过。

## 六、专项意见说明

经审议，公司董事会审计委员会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策与审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。公司董事会审计委员会同意本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事宜。

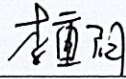
## 七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：艾为电子本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序。相关事项有利于提高募集资金使用效率，有利于公司和全体股东的利益，与公司的业务发展需要和长远战略相吻合，同时亦符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定。

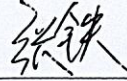
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海艾为电子技术股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字：



李重阳



张铁

